

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/045926 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 23/31**

(74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; c/o Kanzlei Schweiger
& Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002374

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Oktober 2004 (25.10.2004)

(25) Elnrelchungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 50 239.4 27. Oktober 2003 (27.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HETZEL, Wolf-
gang [DE/DE]; Schanzenweg 14, 89564 Nattheim (DE).
THOMAS, Jochen [DE/DE]; Ottilienstr. 46 A, 81827
München (DE).

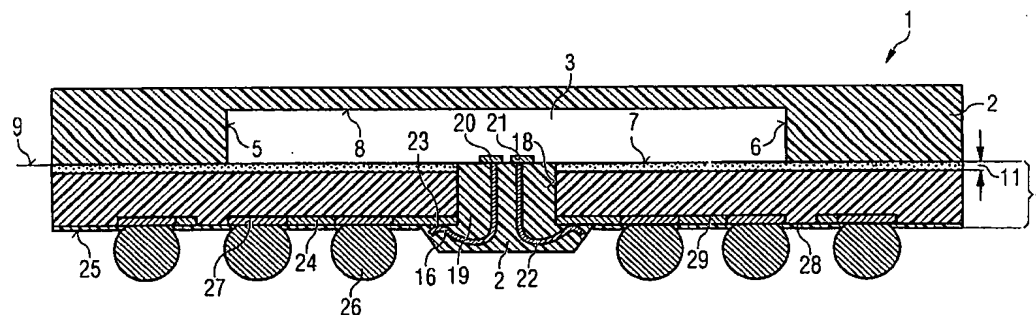
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING SYNTHETIC HOUSING MATERIAL, SEMICONDUCTOR
CHIP AND CIRCUIT SUPPORT, AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUTEIL MIT GEHÄUSEKUNSTSTOFFMASSE, HALBLEITERCHIP UND SCHAL-
TUNGSTRÄGER SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component (1) comprising a synthetic housing material (2), a semiconductor chip (3) and a circuit support (4). The semiconductor chip (3) is embedded in the synthetic housing material (2). The top surface of the semiconductor chip (3) and the synthetic housing material (2) are disposed on a circuit support (4). An elastic adhesive layer (11) is interposed between the circuit support (4) and the synthetic housing material (2) comprising the semiconductor chip (3), thereby mechanically decoupling an upper area from a lower area of the semiconductor component (1).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil (1) mit Gehäusekunststoffmasse (2), einem Halbleiterchip (3) und mit einem Schaltungsträger (4). Der Halbleiterchip (3) ist in eine Gehäusekunststoffmasse (2) eingebettet. Die Oberseite des Halbleiterchips (3) und die Gehäusekunststoffmasse (2) sind auf einem Schaltungsträger (4) angeordnet. Zwischen dem Schaltungs-
träger (4) und der Gehäusekunststoffmasse (2) mit dem Halbleiterchip (3) ist eine elastische Klebstofflage (11) zur mechanischen
Entkopplung eines oberen Bereichs von einem unteren Bereich des Halbleiterbauteils (1) angeordnet.

WO 2005/045926 A2



Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.